# 赤外線放射温度計による構造物に埋め込んだ光ファイバの破断点検出 Infrared-thermometer-based break-point detection of optical fibers embedded in structures 〇萩原園子<sup>1</sup>、李熙永<sup>1</sup>、越智寛<sup>2</sup>、松井孝洋<sup>2</sup>、松本幸大<sup>3</sup>、田中洋介<sup>4</sup>、中村一史<sup>5</sup>、水野洋輔<sup>1</sup>、中村健太郎<sup>1</sup> <sup>1</sup>東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所、<sup>2</sup>東レ、<sup>3</sup>豊橋技科大、<sup>4</sup>農工大、<sup>5</sup>首都大

○S. Hagiwara<sup>1</sup>, H. Lee<sup>1</sup>, Y. Ochi<sup>2</sup>, T. Matsui<sup>2</sup>, Y. Matsumoto<sup>3</sup>, Y. Tanaka<sup>4</sup>, H. Nakamura<sup>5</sup>, Y. Mizuno<sup>1</sup>, and K. Nakamura<sup>1</sup>
<sup>1</sup>FIRST, IIR, Tokyo Tech, <sup>2</sup>Toray Industries, Inc., <sup>3</sup>Toyohashi Univ. Tech., <sup>4</sup>Tokyo Univ. Agr. Tech., <sup>5</sup>Tokyo Metr. Univ. E-mail: shagiwara@sonic.pi.titech.ac.jp

## 1. はじめに

近年、高度経済成長期に集中的に建造された構造物(建物・トンネル・橋梁・ダム・パイプラインなど)の地震による損傷や 経年劣化が社会問題となっている。そこで、炭素繊維強化プラ スチック(CFRP)の現場成形によって、損傷・劣化した箇所を 補修する技術が注目を集めている。CFRPの現場成形法の一つ として、真空含浸法(VaRTM成形)[1]が知られている。これ は、成形型の上に積層した強化繊維基材をプラスチックフィル ムに封入して真空吸引した後、液状樹脂を注入・含浸して硬化 させる成形法である。最近、我々は、VaRTM成形の真空封入 の前に予め光ファイバを配置しておくことで、CFRP中の任意 の位置にセンシング用の光ファイバを埋め込む技術を開発した。 ここでは、万一 CFRP が補強対象(鋼材など)から剥離するな どして埋め込んだ光ファイバが破断した場合に、迅速に破断点 を検出する手法について検討する。

従来、光ファイバの破断点を検出する手法として最も広く使われてきたのは、光パルスの伝搬時間によって位置を分解する 光時間領域反射計(OTDR)[2]である。また、光周波数領域反 射計(OFDR)[3]や光相関領域反射計(OCDR)[4]、多重フレ ネル反射に基づく干渉計[5]も破断点検出に適用可能である。ど の手法も数秒~数分程度の測定時間で精度よく破断点の位置を 決定できる上、システムのコストも低下しつつある。しかし、 光ファイバが埋め込まれた現場では、実用上大きな課題がある。 それは、例えば「ここから13.5m遠方で光ファイバが破断し ている」と判明しても、それが実際に構造物においてどの箇所 なのか直ちには分からない、という問題である。

そこで本発表では、この問題を解決すべく、赤外線放射温度 計(IRT)[6,7]を用いた光ファイバの破断点検出法を提案する。 光ファイバの破断点では光のエネルギーが熱に変わり、周囲の 温度が高くなるため、これを IRT で検出するという原理である。 本手法は、光ファイバの破断点の位置を構造物のどの箇所なの かも含めて精度よく決定できる上、低コストかつリアルタイム に動作するため、現場応用に適しているといえる。以下の実験 では、実際に CFRP に埋め込んだ光ファイバを破断させ、その 位置を検出することで、本手法の有用性を示す。

#### 2. 実験系

詳細は省略するが、VaRTM成形により、各厚さ約0.5mmの CFRP 層をテーパ状に7層、厚さ12mmの鋼材の上に積層し、 幅39mmの短冊状に切断した。その際、Fig.1(a)のように最下 層のCFRPと鋼材の境界に、3本のシリカ単一モード光ファイ バ(SMF;コア径8µm、クラッド径125µm、外径250µm)を 平行に埋め込んだ。埋め込んだ箇所のファイバ長は550mmで あった。この状態で、3点曲げ試験を行い、CFRPが剥離し光フ ァイバが破断するまで、試験体の中央付近に上方から荷重を印 加した(Fig.1(b))。本実験では、3本の破断した SMFのうち、 手前(中央から9mm外側に寄っている)の1本のSMFを用 いた(Fig.1(c))。

いた(Fig. 1(c))。 波長 1551 nm の半導体レーザの出力光を、エルビウム添加光 ファイバ増幅器(EDFA)により任意のパワーまで増幅し、 CFRP に埋め込んだ SMF に入射した。その後、SMF の破断箇所 における CFRP 層表面の温度を IRT によって測定した。CFRP 表 面の放射率は 0.85 とした。室温は約 26 ℃ であった。

#### 3. 実験結果

まず、約27 dBm (= 500 mW)の光を入射してから180 秒経 過したときの IRT 画像を Fig. 1(d)に示す。破断点を中心に高温 となり、高温部は光ファイバの長手方向に沿って楕円状に広が っていた。これは、CFRPの熱的異方性に起因していると考え られる (SMF と CFRPの熱伝導率の違いでは説明できない)。 また、高温部が、埋め込んだ3本のSMFのうち手前のSMFの 破断箇所に対応していることも確認できた。

次に、各入射パワーにおける、破断点付近の温度変化の時間

依存性を Fig. 2(a)に示す。入射パワーに関わらず、時間ととも に温度変化は大きくなり、150 秒程度でほぼ一定となった。温 度変化の収束値は、入射パワーが高いほど大きかった。一般に、 隣接した高温物体と低温物体の温度差の時間変化は指数関数で 与えられる。そこで、指数関数によるフィッティング曲線も表 示したところ、測定値と良い一致を示した。

最後に、光を入射してから 180 秒後の温度変化の大きさを、 入射光パワーに対してプロットしたのが Fig. 2(b)である。横軸 の光パワーは、線形単位(mW)で表示した。入射光パワーが 増加するにつれ、温度変化も線形に増加し、その依存係数は 9.7 ℃/W であった。以上より、入射光パワーが高いほど、コン トラストがより高い状態で破断点を検出できることが示された。

本実験で得られた定量的な数値(飽和時間・依存係数)は、 SMFを埋め込む対象や状況によって変化すると考えられる。今後は、実用化に向けて、この点を明らかにしていく計画である。 しかし、構造物に埋め込んだ光ファイバの破断点を低コストか つリアルタイムに検出する手法として、本手法が有用であると いう結論に変わりはないといえる。



**Fig. 1 (a)** Sample geometry. **(b)** Schematic of fiber breakage caused by peeling of CFRP layers. **(c)** Experimental setup. **(d)** IRT image taken at 27-dBm power, 180 s after light injection.



**Fig. 2 (a)** Temporal variations of temperature change at 5 different incident powers. **(b)** Temperature change (at 180 s after light injection) plotted as a function of incident power.

### 参考文献

- [1] D. Bender et al., Comp. Sci. Technol. **66**, 2265 (2006).
- [2] M. K. Barnoski and S. M. Jensen, Appl. Opt. 15, 2112 (1976).
- [3] W. Eickhoff and R. Ulrich, Appl. Phys. Lett. 39, 693 (1981).
- [4] Y. Mizuno et al., Jpn. J. Appl. Phys. 56, 072501 (2017).
- [5] Y. Mizuno et al., J. Lightw. Technol. **32**, 4132 (2014).
- [6] H. Krips, Stud. Hist. Philos. Sci. 17, 43 (1986).
- [7] N. Hayashi et al., Appl. Phys. Express 6, 076601 (2013).